

技術詞彙表

「3D 查找表」	指	3D 查找表
「8K@60fps」	指	一種視頻解像度及幀率規格，指解像度約為8,000個水平像素及刷新率為每秒60幀的超高清視頻
「ADAS」	指	先進駕駛輔助系統
「AED」	指	自動體外除顫器
「AI」	指	人工智能
「AI 賦能的 IP」	指	一種針對邊緣應用優化的跨域融合計算架構，利用 FLEXA 同步接口技術將 ISP、VPU 及 NPU 等獨立 IP 核集成到緊密耦合的 AI 子系統中
「AIGC」	指	人工智能生成內容
「AIoT」	指	人工智能物聯網
「AiPaaS」	指	AI 平台即服務
「AR/VR」	指	增強現實／虛擬現實
「ASIC」	指	專用集成電路
「ASIL」	指	汽車安全完整性等級
「ASIL D」	指	汽車安全完整性等級 D。其為 ISO 26262 道路車輛功能安全標準中界定的最高及最嚴格的風險等級
「BLE」	指	低功耗藍牙
「BLE 5.3」	指	低功耗藍牙 5.3
「Chromium OS」	指	一種免費、開源、基於 Linux 的操作系統，專為以網絡為中心的任務而設計
「CMOS」	指	互補金屬氧化物半導體
「CPU」	指	中央處理器
「DDR」	指	雙倍數據速率。其為一種用於計算機、服務器、智能手機、嵌入式系統及其他數字電子產品的同步動態隨機存取存儲器(SDRAM)
「畸變矯正 IP」	指	一種用於畸變矯正的 IP，授權予客戶用於自動駕駛芯片

技術詞彙表

「EDA工具」	指	電子設計自動化工具
「ESG」	指	環境、社會及管治
「員工持股計劃」	指	員工持股計劃
「無晶圓廠設計公司」	指	一家設計及銷售半導體芯片但將製造外包予專門晶圓代工廠的公司
「FD-SOI」	指	全耗盡型絕緣體上硅
「FinFET」	指	鱗式場效應晶體管
「FLEXA」	指	本集團開發的一項專有同步接口技術，可將ISP、VPU及NPU等獨立IP核集成到緊密耦合的AI子系統中。通過實現無DDR內存訪問的直接硬件級數據流，其可顯著減輕帶寬瓶頸，為邊緣設備提供超低延遲及高能效的視覺計算。
「FPGA平台」	指	現場可編程邏輯門陣列平台
「FreeRTOS」	指	一種用於嵌入式設備的實時操作系統內核
「GHG」	指	溫室氣體
「GNSS」	指	全球導航衛星系統
「GPGPU」	指	通用圖形處理單元
「HB-PoP」	指	高帶寬堆疊封裝
「HBM」	指	高帶寬內存
「HDR」	指	高動態範圍
「HDR10」	指	高動態範圍
「HDR10+」	指	一種免費的動態元數據HDR格式，通過優化視頻中每個場景的畫質來改進基本的HDR10
「垂直整合製造商」	指	垂直整合製造商
「物聯網」	指	物聯網

技術詞彙表

「IRU」	指	智能渲染單元，一項專有視覺計算技術，採用分佈式渲染架構，以加速圖形渲染並提升現代計算系統的視覺輸出質量
「ISO 26262 標準」	指	一項關於道路車輛電氣及／或電子(E/E)系統功能安全的國際標準。其全稱為「道路車輛－功能安全」
「ISO 27001」	指	信息安全管理体系的領先國際標準，提供基於風險的框架以保護數據的保密性、完整性及可用性
「ISO 9001」	指	一項全球認可的質量管理標準，有助於各種規模及行業的組織提升績效、滿足客戶期望並展示其對質量的承諾
「Linux」	指	一種開源操作系統內核，廣泛用於嵌入式系統、服務器及消費類設備
「LLM」	指	大語言模型
「LPDDR5x」	指	低能耗雙倍數據速率5x，一種用於高性能AIGC平台的高帶寬內存解決方案
「LPDDR6」	指	低能耗雙倍數據速率6，一種用於高性能AIGC平台的高帶寬內存解決方案
「MCU」	指	微控制器單元
「MIPI」	指	移動行業處理器接口
「NB-IoT」	指	窄帶物聯網
「OEM」	指	原始設備製造商
「OSAT」	指	委外半導體封裝測試
「PCIe」	指	外設組件快速互連
「PHY」	指	物理層接口，於MIPI C/D PHY接口的內容中提述
「RTL」	指	寄存器傳輸級
「SAP」	指	系統、應用及產品
「SDK」	指	軟件開發包

技術詞彙表

「SerDes」	指	串行器／解串器
「SiPaaS」	指	芯片設計平台即服務
「SoC」	指	片上系統
「流片」	指	芯片設計的最後一步，將設計數據發送至晶圓廠進行晶圓製造
「TOPS」	指	每秒萬億次運算
「德國萊茵 TÜV」	指	一家獨立國際測試、檢驗及認證機構，認證了公司符合 ISO 26262 標準的設計流程
「UCIe」	指	通用 Chiplet 快速互連
「VeriHealthi」	指	一個提供從芯片定制設計到參考應用的綜合健康檢測解決方案的專有平台